

**本會與高通公司訴訟和解案**  
**有關「台灣產業方案」各項計畫之金額及內容**

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
<p>一、成立台灣營運與製造工程暨測試中心</p>	<p>(一)投資金額：約 5 億美元。            (二)招募員工 1,000 人。            (三)設立「5G 模組設計」、「毫米波測試」及「超音波指紋辨識技術開發」等 3 個卓越中心。</p>	<p>本計畫內容及實質效益：</p> <p>(一)本計畫有助提升台灣為全球產業鏈之布局重心：</p> <p>1、高通公司已成立「台灣營運與製造工程暨測試中心」(Center for Operations, Manufacturing Engineering and Testing in Taiwan, 下稱 COMET 中心)，並設置「5G 模組設計」、「毫米波測試」及「超音波指紋辨識技術開發」等 3 個卓越中心及相關實驗室，作為高通公司供應鏈營運、相關工程及業務發展等海外業務之核心據點，加深與台灣半導體產業及廠商的緊密合作關係。</p> <p>(1)「5G 模組設計」卓越中心：支援台灣 8 項不同的模組產品專案，包括設計、性能調校、系統驗證及除錯。</p> <p>(2)「毫米波測試」卓越中心：設立實驗室研究尖端 5G 技術，將技術開發與執行的重要團隊由美國加州聖地牙哥</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>傳至台灣新竹市。</p> <p>(3) 「超音波指紋辨識技術開發」卓越中心：開始進行共聚物溶劑烘烤 (copolymer solvent baking) 與結晶過程 (the crystallization process) 實驗。</p> <p>(4) 生產測試中心與封包暨熱/機械實驗室：推出晶圓針測、最終測試及系統層級測試相關生產測試中心業務。</p> <p>2、高通公司成立台灣 COMET 中心，建立高通公司在美國總部之外最大的產品測試工程團隊。最初的重點是於台灣進行測試中心整併及整合晶片產品開發與設計部門。最近，高通公司與台灣晶圓製造商進行早期合作開發，共同加速未來節點及技術開發。此外，高通公司與台灣廠商共同開發超聲波產品、成立超聲波指紋辨識軟體及演算法團隊。高通公司成立 5G 模組卓越中心，有助加速 5G 終端客戶產品開發時程。</p> <p>3、第三方研究單位評估前述各項技術領域未來市場樂觀，2025 年市場規模成長率最高者為 5G IoT 模組，超過 95</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度（至 111 年 11 月 30 日止）
		<p>％；超聲波指紋辨識市場規模達 22.2 億美元，與 2020 年相比成長 25％。在執行本計畫前，高通公司與台灣 IC 製造及封測業者為委託製造關係，與終端業者客戶為晶片供應關係；而執行本計畫後，高通公司與台灣業者更深化合作，進行先期合作研發、共同投資及設計開發，有助帶動台灣封測關鍵業者在新技術領域領先，並提升台灣為全球產業鏈之布局重心。</p> <p>4、高通公司 CPU 設計中心已具有進行高階 CPU 性能分析及全球聯合測試的能力，將成為協助台灣廠商進入全球市場的助力。</p> <p>(二) 本計畫帶動台灣相關業者之投資效果顯著：</p> <p>1、108 年 6 月 27 日在新竹科學工業園區舉行 COMET 中心新大樓興建動土典禮，宣布 COMET 中心、5G 測試實驗室、多媒體研發中心及行動人工智慧創新中心均將進駐，並持續進行人才招募與投資。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>2、COMET 中心晶片測試及封裝計畫的合作廠商包括「日月光半導體製造股份有限公司」(下稱日月光)及「矽品精密工業股份有限公司」(下稱矽品)，高通公司已將所承諾的長期資本設備經費投資在與該二公司的合作計畫，已對台灣中南部地區帶來正向的外溢效果及相關產業利益。</p> <p>3、日月光高雄廠所新安裝的測試機台數已大幅成長，以 106 年為基期，成長超過 1200%。因為與日月光和矽品的早期合作的成功，高通公司決定在台灣投資計畫中增添 5G 相關系統級測試之機台設備，5G 相關系統級測試比同類的 4G 測試更加複雜。再者，日月光以高通公司技術發展藍圖，投入新臺幣 90 億元進行研發創新，例如智慧工廠、5G 毫米波 (mmWave) 及 AR 實驗場域、打造相關實驗室等項目。高通公司在測試機台方面進行合作並委託日月光進行 5G 相關封測業務之方式，有助降低台灣業者</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>的資本支出風險。</p> <p>4、高通公司將全球半導體封裝測試業務重新整合至以台灣為重心，與日月光、矽品深度合作，投資各項高階設備與人才訓練，大幅提升台灣的封測競爭力，讓台灣成為高通公司全球最大的供應鏈營運重心。</p> <p>5、據第三方研究單位評估，高通公司與矽品在產品設計、製造及產能進行合作與討論，雙方的合作計畫可提升矽品對封測技術的掌握及研發能力，該項合作計畫亦已促進 2,000 人以上的就業機會，可望帶動約 14 億家計儲蓄與消費金額。</p> <p>6、高通公司在支援半導體封裝測試服務 (SATS) 場域方面，已與台灣晶圓廠就產品或良率技術問題進行合作，有助縮短資訊獲取及決策時間，並與測試設備廠商及系統合作夥伴持續合作，以改善整體產業的解決方案。</p>
二、5G 技術與	(一)投資金額：約 1 億	本計畫內容及實質效益：

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
產品開發	<p>美元。</p> <p>(二) 設立 5G 測試環境實驗室並提供教育訓練。</p> <p>(三) 為中小企業進行 5G 教育訓練。</p> <p>(四) 支援台灣行動通訊營運商啟用 5G 網路。</p> <p>(五) 建立 5G 測試裝置生態系及製造環境。</p>	<p>(一) 高通公司已設立 5G Innovation Lab，係亞太地區具備最佳 5G 測試環境實驗室之一：</p> <p>1、107 年 9 月 21 日宣布 Innovation Lab 已具備 5G 測試能力，可提供全面 5G 測試環境，並為高通公司技術平台支援的 5G 發展專案提供關鍵資源及技術經驗，同時將為台灣無線通訊產業提供 5G 相關的教育訓練。</p> <p>2、5G 測試環境實驗室將提供包含中小企業在內的台灣公司，使其接觸有關全球發展趨勢、市場需求及最新規範等全球性資源及資訊；該實驗室並將協助縮短台灣公司 5G 產品之上市時間，進一步提升台灣於全球 5G 供應鏈及生態系所扮演之關鍵角色。</p> <p>3、已擴大升級 Qualcomm Innovation Lab-Taiwan，建置完善的 5G 測試環境，自 108 年以來，共支援逾 363 項 5G 客戶專案，並與 30 家全球製造商及營運商持續進行合作。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>4、已擴增 5G 實驗室，新增部分 R16 標準功能，提升 5G 實驗室效能及測試效率，並擴增 5G GCF/PTCRB (即全球認證論壇/個人通信服務型號認證評估委員會) 及北美運營商測試案例的測試覆蓋率。</p> <p>(二) 高通公司已與相關產業聯盟及公會合作，為中小企業進行 5G 教育訓練，有助中小企業轉型升級：</p> <p>1、高通公司已加入台灣 5G 產業發展聯盟，提供 5G 技術專業知識，協助加速台灣 5G 產業與價值鏈發展。</p> <p>2、高通公司已與台灣區電機電子工業同業公會 (TEEMA) 合作推出 5G 無線技術線上學習課程，以協助台灣創新中小企業在 5G 全球產業鏈中拓展商機。目前已有 463 家中小企業共 1,463 名員工註冊參加線上學習課程。</p> <p>3、109 年 9 月 28 日至 29 日高通公司與台灣區電機電子工業同業公會 (TEEMA) 與台北市電腦公會 (TCA) 在台北及高雄合作舉辦 Qualcomm Tech Week，主題包含 AR/VR、5G</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>模組、人工智慧、機器人、智慧城市及物聯網等，2 天活動共計 240 位學員參與。</p> <p>4、109 年 11 月 30 日高通公司參與高雄市政府所主導成立之「5G AIoT 國際大聯盟」，除培育南台灣人才外，亦積極強化在地連結，協助產業前進全球市場。</p> <p>(三) 高通公司已協助台灣行動通訊營運商，為台灣消費者進行規劃及布局 5G 行動通訊服務：</p> <p>1、高通公司已與台灣行動通訊營運商進行 5G 測試網路兼容性測試，及辦理 5G 教育訓練，協助台灣行動通訊營運商為 5G 網路上市做好準備。</p> <p>2、高通公司已開始進行 5G 模組先期認證支援，並與台灣測試廠商合作；高通公司已提供模組預認證支援服務，與當地測試中心合作，為全球運算、用戶端設備及行動路由器客戶提供服務。</p> <p>(四) 高通公司已採取具體行動，協助台灣廠商運用 5G 裝置，</p>



各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>提供轉型解決方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、109 年 12 月 16 日高通公司與中華電信、日月光聯手打造全球首座 5G mmWave 智慧工廠正式啟動記者會，首次導入台灣廠商 5G 小型基地台、智慧眼鏡及新創公司之合作。</li> <li>2、110 年 4 月 20 日高通公司宣布與中華電信、微軟、宏碁、華碩、精英、英華達及台北市電腦商業同業公會 (TCA) 等成立「企業數位轉型行動陣線」，將以企業專網建置到搭載高通晶片運算平台的個人筆電，提供企業數位轉型整體解決方案。</li> <li>3、110 年 9 月 30 日高通公司啟動與中華電信、亞旭電腦、精英電腦、台灣微軟、力新國際及 XRSPACE (未來市) 等公司所共同支持之「5G 創新科技學習示範學校」計畫，選定台北市、台南市及高雄市共 3 所國中導入創新軟體設備資源，首度運用 5G 行動網路、常時連網及 VR 進</li> </ol>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>行三校混合式遠距共學。</p> <p>4、110 年 10 月高通公司已與中華電信、啟碁科技及廣達電腦合作，在國家兩廳院場域建置 5G 毫米波多維度展演空間，達到異地共演、虛實整合的多視角觀演體驗，為 5G 毫米波商業化發展樹立里程碑。</p> <p>5、高通公司將支援日月光智慧工廠第二階段，引進新的 OEM 廠商及電信公司進行合作。</p> <p>6、111 年 9 月 21 日高通公司宣布與中華電信公司合作「無線關愛」計畫，將在南台灣選定學校協助 5G 創新學習課程、智慧校園的發展，並為參與該計畫的教師提供培訓課程。</p> <p>7、111 年 8 月 23 日高通公司已與日月光公司召開合作建置 5G 毫米波專用網路的啟動會議，並於同年 9 月 28 日由日月光公司宣布與高通公司、亞太電信、亞旭電腦等廠商展開專案計畫，透過 5G 獨立組網與毫米波雙連線等先</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>進 5G 技術，開發 5G 系統整合解決方案，導入日月光公司實際上線應用，打造全球首座 5G SA mmWave NR-DC 智慧工廠，將有助於工廠智慧化的數位轉型。</p>
<p>三、協助台灣 OEM 廠商拓展全球市場及開發新興產品</p>	<p>(一)投資金額：約 5 千萬美元。 (二)支援台灣 OEM 及 ODM 廠商開發高價值新興產品。</p>	<p>本計畫內容及實質效益：</p> <p>(一)高通公司已支援台灣 OEM 及 ODM 廠商加速開發高價值新興產品領域 (例如 AR/VR 眼鏡、智慧型穿戴裝置、搭載 ARM 的 Windows 裝置、工業物聯網、AI Camera、3D Camera 等)，拓展全球市場：</p> <p>1、AR/VR 眼鏡：Google、Facebook 及 HTC 等開發頭戴式顯示器 (HMD) 之領導廠商將採用高通公司晶片。</p> <p>2、搭載 ARM 的 Windows 裝置：高通公司為目前唯一一家矽晶供應商支援搭載 ARM 的 Windows 裝置，搭載 ARM 的 Windows 裝置將提供消費者支援完整 Windows，且可隨時上網而相當便於攜帶，有全天電力續航能力之裝置。基於台灣 OEM/ODM 廠商對於設計以 Windows 為基礎之產品</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>的豐富經驗，其將有相當機會於上述新興市場領域之成長中獲益。</p> <p>3、工業物聯網：高通公司將大量投資以促進物聯網 (IoT) 市場，包含高通公司近期宣布的 Qualcomm 無線邊緣服務 (QWES) 亦將支援工業物聯網之應用。</p> <p>(二) 高通公司已開始提供台灣廠商有關鏡頭、顯示器、記憶體、電力、效能、散熱及先期認證實驗室服務，台灣廠商已開始在全球推出相關產品。</p> <p>(三) 高通公司已與台灣關鍵零組件 (記憶體、顯示器及感測器) 廠商進行合作及提供技術支援，並為台灣廠商共 200 名工程師辦理相關工作坊活動，持續強化台灣重要零組件生態系。</p> <p>(四) 高通公司已協助台灣廠商於全球市場擴展與競爭：</p> <p>1、高通公司已透過 5G 測試環境實驗室，提供超過 200 項 5G 裝置開發與預認證實驗室服務，提供客戶超過 24 萬測試服務小時，並協助超過 363 項台灣廠商的 5G 產品於</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>全球上市。</p> <p>2、110 年 5 月 13 日高通公司宣布「高通台灣永續合作計畫」，該計畫係由高通公司、矽品公司及 10 家位於高雄及台南的供應商所共同合作，該等供應商均為台灣半導體供應鏈的中小企業。藉由本計畫，高通公司提供獎金予通過遴選的公司，應用於再生能源及水循環科技。本計畫旨在協助南台灣的中小企業，在全球半導體市場中具有成本競爭力，提升其在永續發展中之角色，並減少碳足跡。</p> <p>3、110 年 7 月高通公司與華碩公司合作推出「Smartphone for Snapdragon Insiders」智慧型手機，協助台灣廠商拓展全球市場。</p> <p>4、高通公司已與台灣 OEM/ODM 廠商推出行動路由器計畫、Windows on Snapdragon 計畫及運營商模組認證，並協助廠商於全球拓展產品市場。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
<p>四、在臺灣進行研發新創及生態系發展</p>	<p>(一)投資金額：約 5 千萬美元。</p> <p>(二)設立「多媒體研發中心」、「行動人工智慧創新中心」及「CPU 設計研發中心」。</p> <p>(三)舉辦「高通台灣研發合作計畫」，提供學校研發經費。</p> <p>(四)舉辦「高通台灣創新競賽」，提供新創團隊獎金及育成資源。</p>	<p>本計畫內容及實質效益：</p> <p>(一)高通公司已成立「多媒體研發中心」、「行動人工智慧創新中心」及「CPU 設計研發中心」，進行研發新創及生態系發展：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、「多媒體研發中心」將聚焦於 3D 感測、3D 人臉偵測及辨識技術、AR/VR 等相關技術。</li> <li>2、「行動人工智慧創新中心」將著重於終端裝置的 AI 平台及應用研究，並將借助台灣中小企業及 OEM/ODM 廠商對產品設計的能力與開發經驗，共同拓展智慧型手機及物聯網終端裝置上的 AI 應用。</li> <li>3、「CPU 設計研發中心」將持續擴展在台灣的研發量能。</li> </ol> <p>(二)高通公司已持續舉辦「高通台灣研發合作計畫」，提供學校研發經費，培育人才並提升台灣創新能量：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、高通公司已持續舉辦 4 屆「高通台灣研發合作計畫」(簽約計畫學校數各年度分別為 108 年 14 所、109 年 10 所、110 年 10 所、111 年 10 所；總計簽署 51 件研發合作契</li> </ol>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>約), 與簽約學校在 5G 無線通訊、機器學習、人工智慧、影像視覺及多媒體等尖端科技領域進行合作研究。</p> <p>2、高通公司已與參與研發合作計畫的大學辦理「高通台灣研發合作成果發表會」, 已與 14 所大學合作, 累計超過 560 位大學師生參與, 並產出 98 件研發計畫、360 篇國際學術論文及 18 件專利申請案, 具體呈現各大學研究團隊尖端科技領域的研發合作成果。其中, 第 3 屆「高通台灣研發合作計畫」共有 10 所大學參與, 在車用自駕、智慧城市、健康照護及交通等多項領域與高通公司進行研發合作, 完成 35 項計畫, 提出 170 篇學術論文, 並獲得 12 項專利申請。</p> <p>(三) 高通公司已持續舉辦「高通台灣創新競賽」(QITC), 提供新創團隊獎金及育成資源, 發掘及育成具創新性的中小企業與產品:</p> <p>1、高通公司已持續舉辦 4 屆「高通台灣創新競賽」及巡迴</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>說明會，向中小企業、新創公司及個人進行徵件說明及提問交流，透過發掘及育成具創新性的中小企業與產品，鼓勵新創團隊於 5G、物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發新興產品，協助支持台灣資通訊產業生態系成長。</p> <p>2、入選「高通台灣創新競賽」的新創團隊將獲得 1 萬美元獎金外，並將參與高通公司提供的育成計畫（包括商業輔導協助、工程資源協助、參與相關工作坊及智慧財產權培訓等課程，並可獲得專利申請獎勵）。</p> <p>3、高通公司已持續舉辦 4 屆「高通台灣創新競賽」決賽及成果發表活動，提供入圍及獲獎團隊獎金（各年度獎金總數分別為 108 年 40 萬美元、109 年 42.5 萬美元、110 年 40 萬美元、111 年 40 萬美元），協助其業務發展。高通公司亦持續運用其全球產品開發及行銷團隊，協助入圍團隊鏈接國際市場，具體辦理情形如下：</p>



各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>(1)109 年 3 月 29 日高通公司邀請入圍第 1 屆「高通台灣創新競賽」的 2 家新創公司，成為高通公司全球商用生態系的成員。</p> <p>(2)109 年 11 月 20 日高通公司辦理「高通創新連結國際論壇」，分享高通公司如何推動台灣新創進入國際市場，並邀請第 2 屆「高通台灣創新競賽」10 家潛力新創向創投、加速器及企業創新部門簡報各項尖端科技應用產品。</p> <p>(3)目前已育成 39 家新創公司，且在高通公司提供的獎勵方案下，新創公司共申請 35 項專利；6 家新創公司曾獲美國消費性電子展 (CES) 新創大獎；6 家新創公司成為高通商用生態系 (QAN) 成員。</p> <p>4、109 年 3 月 9 日高通公司宣布啟用「高通台灣創新中心」(Qualcomm Innovation Center, Taiwan)，作為「高通台灣創新競賽」基地，配備先進儀器設備，可迅速進行</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>產品原型設計及互通性測試，提供諮詢及技術支援服務，同時擁有供會議、知識交流及培訓使用的工作空間。</p> <p>5、110 年 11 月高通公司參與高雄市政府辦理之「2021 高雄新創大賽」，提供培訓資源，協助新創公司瞭解智慧財產權的保護策略與專利布局。</p> <p>6、111 年 1 月 13 日高通公司宣布第 4 屆「高通台灣創新競賽」正式起跑，入圍及決賽團隊獎金總額為 40 萬美元。高通公司將舉辦 4 場徵件說明會，2 場為線上說明會，另外 2 場實體說明會於台南沙崙智慧綠能科學城的 TTA 南部據點及高雄亞灣新創園舉辦。</p> <p>7、111 年 4 月 28 日高通公司宣布第 4 屆「高通台灣創新競賽」10 家新創團隊入圍名單，為運用 5G、AI 與機器學習、RF 定位演算、區塊鏈等創新技術投入智慧醫療、資安、低延遲視訊串流、消費分析新零售、智慧工廠及無紙化認證等領域。各隊除獲得 1 萬美元入圍獎金外，並</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>將開展為期 6 個月的育成計畫。</p> <p>8、111 年 9 月 21 日高通公司宣布在高雄「亞洲新灣區」5G AIoT 創新園區建立「高通南台灣創新中心」，該中心重點將透過先進的測試設備及 5G 專用網路支援該地區的新創公司，並使南台灣的新創公司能直接接觸高通公司的技術、開發創新產品的技術支援及與技術專家的交流機會。</p> <p>9、111 年 9 月 21 日高通公司已與高雄展覽館公司簽署合作意向書，由高通公司培育的新創公司在高雄展覽館提供 5G 及 AI 應用解決方案，共同推進新創生態系、5G 垂直應用及專用網路商業化。</p> <p>(四) 高通公司已參與新創貿易展活動，並與相關公會辦理人工智慧 AI 教育訓練課程：</p> <p>1、108 年 11 月 14 日至 16 日高通公司參與 Meet Taipei 創新創業嘉年華活動。</p>

各項計畫	KPI	辦理情形與推展進度 (至 111 年 11 月 30 日止)
		<p>2、108 年 12 月 10 日科技部、高通公司及 Techstars 新創加速器共同開設「新創生態圈經營計畫」合作啟動記者會，加強台灣新創與國際間的連結。</p> <p>3、108 年、109 年、110 年及 111 年迄今高通公司已與台北市電腦商業同業公會 (TCA) 共同辦理計 13 場次 (每場次各 3 天) 中小企業及新創團隊的人工智慧 AI 教育訓練課程，共計有 435 名人員參與。</p> <p>4、110 年 6 月高通公司參與 InnoVEX 新創展會，並與台北市電腦商業同業公會 (TCA) 合作，資助「InnoVEX Forum 2021 x Qualcomm」講座活動。</p> <p>5、110 年 11 月 18 日高通公司以線上方式辦理「2021 Meet Taipei 高通影響力新創線上論壇」，並安排 QITC 新創團隊進行對談，分享商業模式視野及創業家思維。</p>